PASSIVE SYSTEM ALLIANCE
Prosperity Dielectrics Co., Ltd.

信昌電子陶瓷股份有限公司
2025年法人說明會
(Stock code: 6173)

報告日期:2025年5月27日

投資人關係聯絡人：發言人 羅夏盈
Email：IR@pdc.com.tw
電話：03-4753355

Copyright © by Prosperity Dielectrics Co., Ltd. | All rights reserved.

PSA

報告內容

- 公司概述
- 財務績效
- 主要市場展望
- 營業聚焦與機會

公司概述

信昌電陶

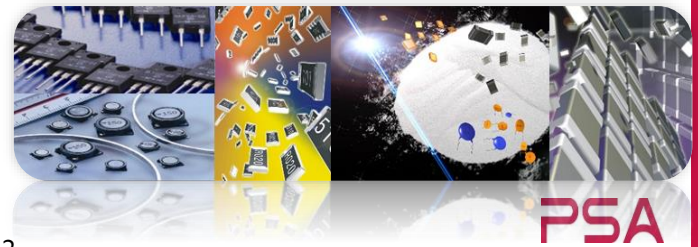
- •成立日期　1990年6月
- •資本額　新台幣17.2 億
- •員工人數　748
- •品牌　PDC
- •營業額　2024年 NT$37.2億
2025 Q1 NT$ 9.4 億

營運據點

- •台灣　桃園廠 / 楊梅廠
- •中國　吳江廠/ 東莞辦公室

生產經歷

- •MLCC/CR　Since 1990　(35 years)
- •Powder　Since 1995　(30 years)

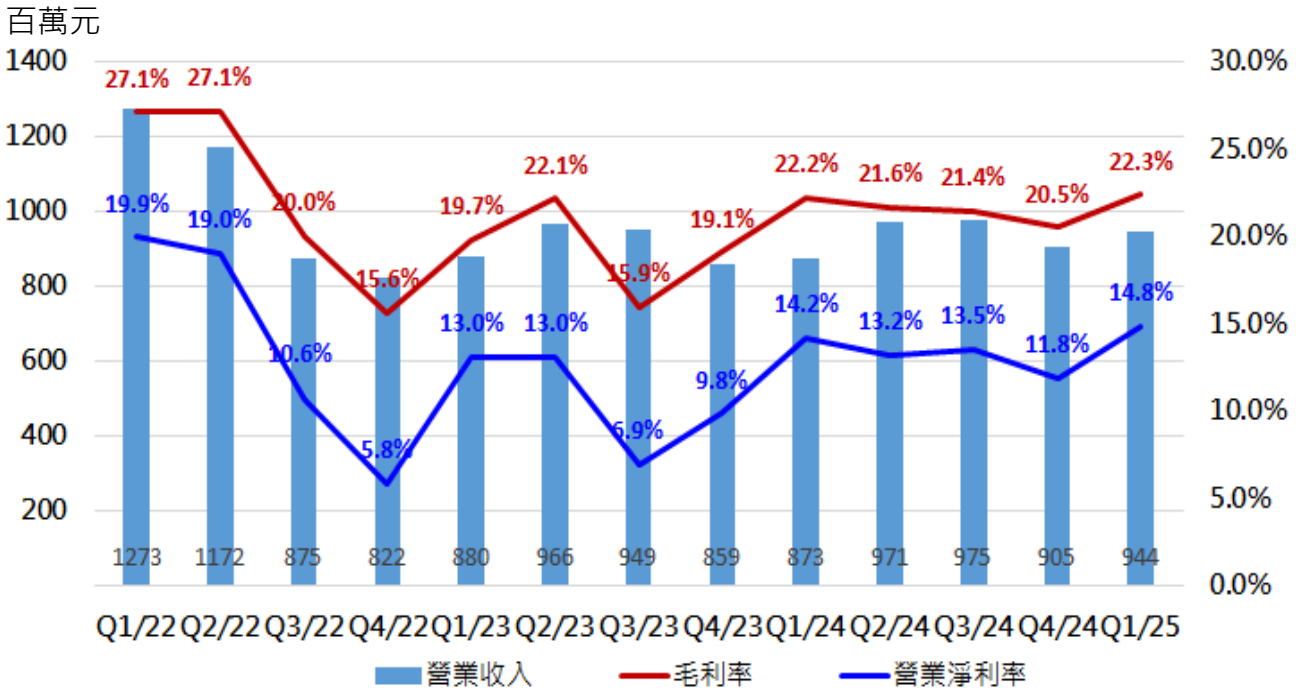


合併綜合損益表比較

單位:台幣百萬元;每股盈餘為元

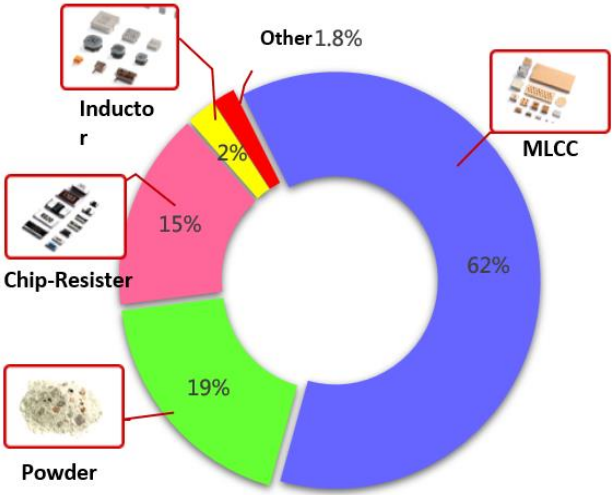
	2025 第一季	2024 第四季	QoQ	成長(%)	2024 第一季	YoY	成長(%)
營業收入	944	905	39	4%	873	72	8%
營業毛利	211	185	26	14%	194	17	9%
毛利率(%)	22.3%	20.5%	1.9%		22.2%	0.1%	
營業淨利	140	107	33	31%	124	16	13%
營業淨利率(%)	14.8%	11.8%	3.0%		14.2%	0.6%	
稅前淨利	153	132	21	16%	185	(32)	-17%
歸屬本公司業主之稅後淨利	120	105	16	15%	146	(25)	-17%
稅後淨利率(%)	12.8%	11.6%	1.2%		16.7%	-4.0%	
每股盈餘(元)	0.7	0.62	0.08		0.85	(0.15)	

營收/毛利率/營業淨利率趨勢

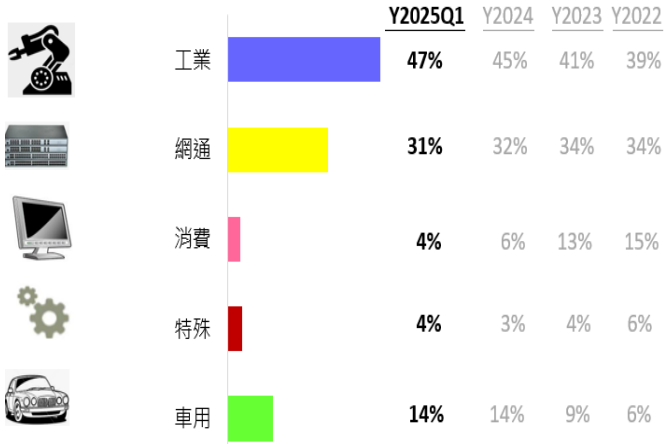


2025 Q1 營收比重

產品別銷售比重



元件產品終端應用銷售比重



- 安規/高功率/高可靠度/客製化/低損之被動元件及介電陶瓷粉末為本公司主力產品.
- 終端應用主要在工業:因AI Server/Data center/PD3.1 快充/機器人馬達電源模塊之業績逐步發酵而增加
- 消費應用市場非聚焦重點,比例持續縮減.
- 特殊品如醫療/航空...領域業績亦有突破.
- 車用市場持平,待後續承認專案發酵.

核心競爭力

材料技術

為國內唯一能自製介電陶瓷粉末,包含圓板電容,MLCC,微波瓷粉及LTCC等高階產品粉末原材料之公司.

設計能力

具自動化設備設計能力,可快速提出符合客戶要求之產品設計.

垂直整合

因應市場快速多變之需求,可迅速垂直整合原料/製程/設備技術,提供品質穩定及成本優勢之產品.

多元產品

提供完整之高功率、高可靠度電容、電阻、電感之所有被動元件,滿足一次購足之需求.

產品規劃及應用

- 4G基站
- 伺服器
- Modem/Router/ STB
- 電源供應器
- 消費電子產品

- AI伺服器
- BBU,PD3.1電源
- 電動車
- 工業機器人
- 5G基站
- 醫療、航太
- 智慧電網

- 人型機器人
- 自駕車
- AI 基礎設施
- AI 資料中心
- 6G相關應用
- 電動車無線充

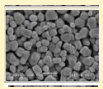
2014

營業收入:NT 2.51B
營業毛利率:18.2%
EPS: 0.75

產品主軸
-元件:工業、網通、消費用高功率MLCC,CHIP-R ,Inductor

-材料:Disc,MLCC介電陶瓷粉末

800nm



600nm

2024

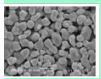
營業收入:NT 3.72B
營業毛利率:21.4%
EPS:2.91

2025 Q1

營業收入:NT 0.94B
營業毛利率:22.3%
EPS:0.7

產品主軸
-元件:工業、網通、車用、醫療、航太用高功率高可靠度MLCC,CHIP-R ,Inductor

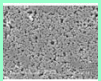
-材料:Disc,高規格MLCC,LTCC,微波介電陶瓷粉末



400nm

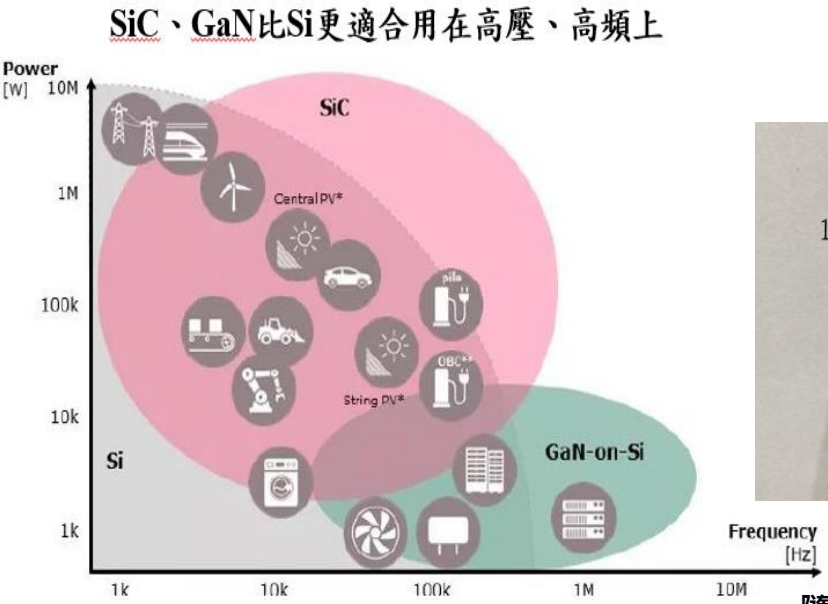
250nm

250nm

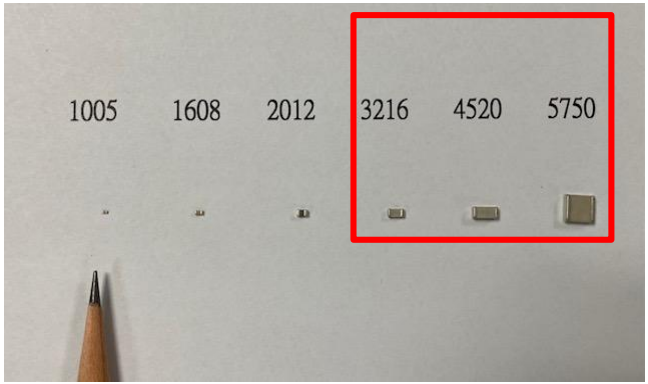


200nm

應用市場趨勢



資料來源:英飛凌



- 隨著第三代半導體(GaN,Sic)的普及應用帶動大尺寸被動元件商機越趨擴大.
- >= 3216尺寸之MLCC於數量需求上雖只佔3.5%~4%,但需求總金額約佔30%~35%.

終端應用產品

Automotive

EV Chargers

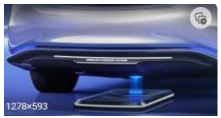
Lighting For Sport & Industry

Robots

Data Center

PD3.1 fast charger

AI Server Power



Wireless Charger/EV

BBU

市場聚焦&主軸產品

Mid/Hi-Voltage & High Reliability
1206~2225 100V-6KV
10uF → 100uF

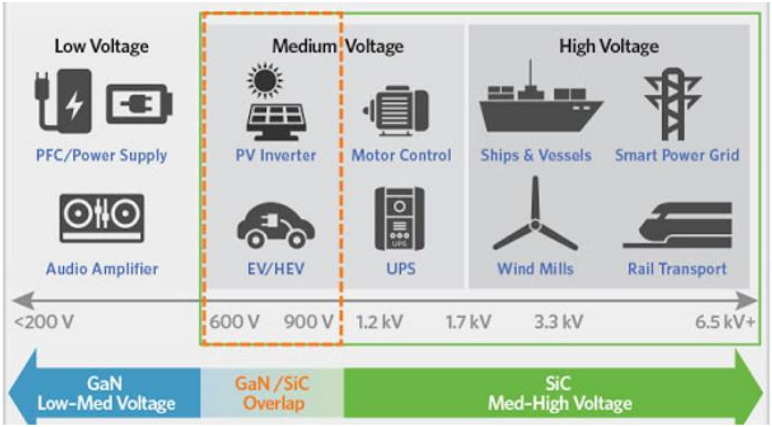
Mega Cap
Chip Size 0612 to 1225
PR 1W to 2W
航空,醫療,軍用...特殊領域
開發各式堆疊架構

Safety Certificated Cap.(X1/Y2,X2/Y3)
1206~2220 (3000V/5000V)
→ 車規+安規 產品開發

LLC NPO
1206~2220/630V~2,000V)
10nF → 100nF
替Film Capacitor

Low DC BIAS Cap. (X7T)
1210~2220 250V-1KV
1uF → 10uF
替代鉭電容

ODM (X7R/NPO) Ultra Big size
3035~13060(~10,000V)
航空,醫療,軍用...特殊領域
以PME為主



Automotive Certificate Cap.(X7R/NPO)
1206~2220 50V-4KV
10uF → 100uF
高容規格開發

ODM (X7R/NPO) Discoidal/Array
航空,醫療,軍用...特殊領域
多孔特殊規格之開發

Automotive Certificate Chip-R
Wide Terminal
Metal strip
Anti-Sulfur
Triple & High Power Surge
Thick film Low TCR

資料來源:Yole、福邦投顧彙整

Metal strip CSR
Chip Size 0805 to 2512
PR 0.5W to 3W

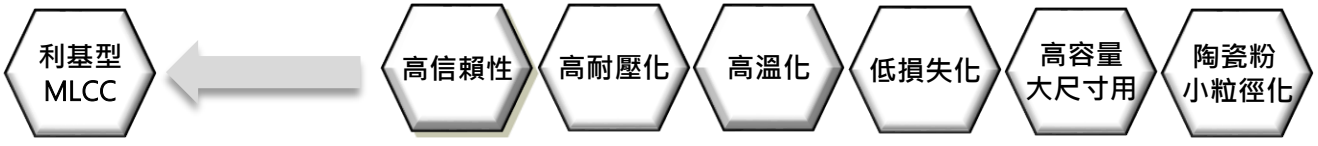
Low TCR CSR
Chip Size 0805 to 2512
PR 1/8W to 2W

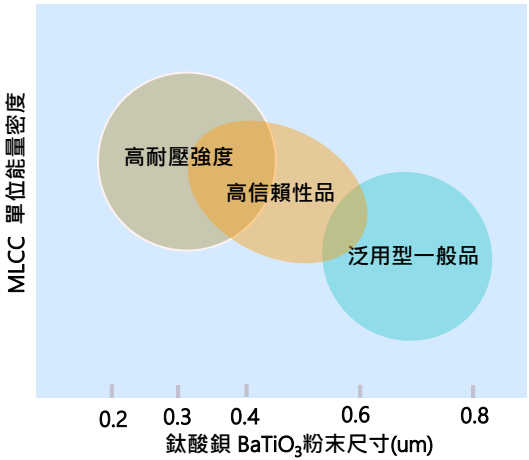
HV+UL Safety Certification
Chip Size 0603 to 2512
WV 200V to 3KV
UL/IEC/CQC 62368

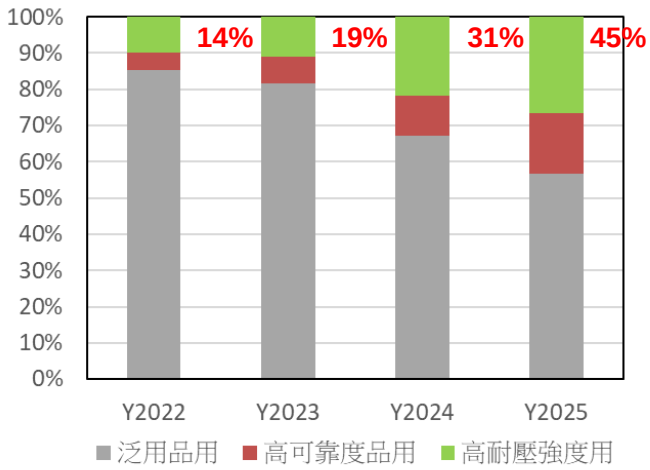
2x/3x High Power CHR
Chip Size 0603 to 2512
PR Max 3W

Anti-Surge CHR
Chip Size 0603 to 2512
PR Max 2W

PDC MLCC陶瓷粉末持續轉向利基產品應用







機會

- 隨著美國貿易戰及地緣政治變化, PDC主要產品之生產及行銷基地皆位於台灣,相對增加接單機會.
- 隨著GaN 、SiC半導體普及,終端產品功率需求率提升,使得SMD高功率高可靠度被動元件需求大增.
- 展望2025,如前述AI Server 、Data center、 工業機器人、 新能源車、PD3.1 快充、智能電網、Medical 、 Aerospace ....為主要市場預估成長較高之領域,PDC大尺寸、高功率MLCC/ Chip-R應用機會增加.
- 高可靠度NPO MLCC 取代Film Cap及 X7R,X7T MLCC取代 Film Cap及鋁、鉭電解電容,致應用大增.
- 5G應用之相關射頻元件大量增加，進而帶動LTCC及高頻低介電濾波應用陶瓷粉末需求增加.
- 隨著EV市佔逐漸提高及車用與充電樁相關需求升高，應用於車載及充電設備之陶瓷粉末隨之增加.

營業聚焦

- MLCC、 Chip-R –
  - 針對高成長之應用市場領域，持續開發更高功率及高電容量之MLCC及高功率Chip-R.
  - 具材料自主開發及製程技術能力， 可有效配合中高壓及大尺寸之特殊MLCC導入高附加價值之市場，及降低成本提升競爭力.

- 介電陶瓷粉末 –
  - 持續開發高階、高溫、高壓、高容、及特殊應用MLCC介電陶瓷粉.
  - 因應5G與AI應用市場成長需求，持續開發高階及特殊應用微波粉末.
  - 持續開發各系列RF/高頻元件用LTCC材料與Cu電極製程MLCC介電陶瓷粉.

Thank you!

本資料均屬機密，僅供指定之收件人使用，未經寄件人許可不得揭露、複製或散佈本信件。

This message and any attachments are confidential and may be legally privileged. Any unauthorized review, use or distribution by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please immediately notify the sender, completely delete this documents, and destroy all copies. Your cooperation will be highly appreciated.